

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

인텍플러스 (064290)

후공정 병목 해소 과정에서 빛나는 검사장비업체

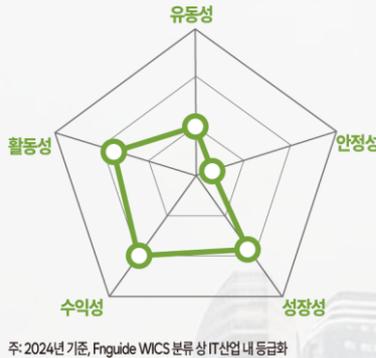
체크포인트

- 인텍플러스는 반도체 외관검사분야, 반도체 Mid-End 분야, 디스플레이 분야, 2차전지 외관검사 분야를 대상으로 하는 외관검사장비 전문 제조업체. 머신비전기술을 통해 표면 형상에 대한 영상 데이터를 획득, 분석 및 처리하는 3D/2D 자동외관검사장비 및 모듈을 개발하여 판매
- 반도체 Mid-End 분야인 FC-BGA 기판 검사 장비 시장에서 약 70~80%의 글로벌 점유율을 차지. TSMC, Ibiden, Shinko, 삼성전기 등 글로벌 Top-tier 고객사와의 협업을 통해 기술력 입증 및 독보적인 레퍼런스 축적. 이를 기반으로 CoWoS 등 첨단 패키징 검사 영역으로 확장 중. 대만 OSAT에 CoWoS 장비를 선적(2025년 9월)해 퀄리피케이션 진행 중이며, 2026년 양산 수주 가능성 부각. 한편, 북미 대형 IDM 고객사와는 대면적 첨단 패키징 검사 프로젝트를 공동 수행하며 AI/HPC용 차세대 패키징 검사에서 단독 벤더 체제를 확보할 가능성이 높음
- 2025년 매출은 930억 원(+11% YoY), 영업이익 14억 원(OPM 1.5%)으로 흑자전환 예상. 2026년에는 매출 1,170억 원·영업이익률 두 자릿수 회복 전망. 현재 2026E PER 18.8배는 글로벌 Peer(Camtek 25.6배, Onto 20.7배, 고영 32.9배) 대비 저평가, 실적 정상화 시 멀티플 리레이팅 여력 큼

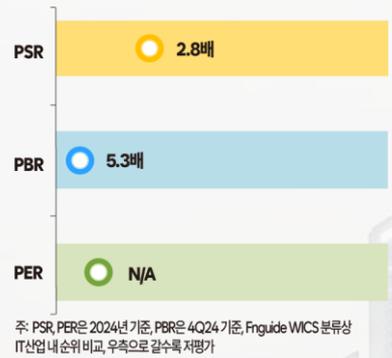
주가 및 주요이벤트



재무지표



밸류에이션 지표



글로벌 FC-BGA 검사장비 1위 지위

인텍플러스는 1995년 KAIST 출신 연구진이 창립한 반도체 외관검사분야, 반도체 Mid-End 분야, 디스플레이 분야, 2차전지 외관검사 분야를 대상으로 하는 외관검사장비 전문 제조업체. FC-BGA 기판 검사 장비 시장에서 약 70~80%의 글로벌 점유율을 확보하며 사실상 독과점적 지위를 차지. TSMC, Ibsiden, Shinko, 삼성전기 등 글로벌 Top-tier 고객사와의 협업을 통해 독보적인 레퍼런스를 축적했으며, 경쟁사 진입이 어려운 고부가 시장에서 장기 성장성을 보장하는 기반 마련

AI/HPC 확산과 후공정 병목, 첨단 패키징 검사로의 확장

AI/HPC 수요 폭증은 CoWoS/HBM 등 첨단 패키징 공정에서 심각한 생산 병목을 야기함. 이는 단순 용량 증설이 아니라 정밀 검사 장비 투자 확대로 이어지는 추세. TSMC는 CoWoS 월간 캐파를 2024년 3.5만 장에서 2025년 말 7~8만 장, 2026년 말 9~10만 장으로 확대할 계획이며, 이러한 캐파 확대 과정에서 수율 안정화와 품질 보증을 위한 검사 장비의 중요성이 크게 부각될 것으로 전망됨. 인텍플러스는 기판 검사에서 확보한 기술력을 기반으로 CoWoS와 하이브리드 본딩 등 패키징 검사 영역으로 외연을 확장 중. 2025년 9월 대만 OSAT에 CoWoS 검사 장비를 선적해 퀄리피케이션을 진행 중. 또한 북미 대형 IDM과 대면적 패키징 검사 프로젝트를 수행하며 차세대 패키징 검사 분야에서 단독 벤더 지위를 확보할 가능성이 큼

실적 턴어라운드와 밸류에이션 리레이팅

2025년 매출은 930억 원(+11% YoY), 영업이익 14억 원(OPM 1.5%)으로 흑자 전환 기대. 구조 조정 효과와 반도체 고마진 매출 비중 확대가 맞물리며 2026년에는 매출 1,170억 원과 영업이익률 두 자릿수 회복 예상. 현재 2026E PER 18.8배는 글로벌 Peer(Camtek 25.6배, Onto 20.7배, 고영 32.9배) 대비 저평가 수준이며, 후공정 병목 해소 국면에서 CoWoS 퀄리피케이션-글로벌 고객 다변화-비용 구조 정상화가 맞물릴 경우 멀티플 리레이팅이 본격화될 것으로 예상됨

Forecast earnings & Valuation

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025F | 2026F |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 매출액(억원) | 1,188 | 748 | 839 | 930 | 1,094 |
| YoY(%) | -0.7 | -37.1 | 12.1 | 10.9 | 17.6 |
| 영업이익(억원) | 194 | -111 | -156 | 14 | 112 |
| OP 마진(%) | 16.3 | -14.8 | -18.6 | 1.5 | 10.3 |
| 지배주주순이익(억원) | 163 | -108 | -119 | 20 | 123 |
| EPS(원) | 1,284 | -844 | -923 | 155 | 958 |
| YoY(%) | -28.1 | 적전 | 적지 | 흑전 | 518.4 |
| PER(배) | 10.7 | N/A | N/A | 116.4 | 18.8 |
| PSR(배) | 1.5 | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.1 |
| EV/EBITDA(배) | 9.1 | N/A | N/A | 76.1 | 19.4 |
| PBR(배) | 2.6 | 6.9 | 2.8 | 4.8 | 3.8 |
| ROE(%) | 27.7 | -17.5 | -23.4 | 4.3 | 22.8 |
| 배당수익률(%) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

| | |
|---------------|-----------------|
| 현재주가 (9/18) | 18,030원 |
| 52주 최고가 | 18,030원 |
| 52주 최저가 | 8,070원 |
| KOSDAQ (9/18) | 857.11p |
| 자본금 | 64억원 |
| 시가총액 | 2,319억원 |
| 액면가 | 500원 |
| 발행주식수 | 13백만주 |
| 일평균 거래량 (60일) | 28만주 |
| 일평균 거래액 (60일) | 35억원 |
| 외국인지분율 | 0.00% |
| 주요주주 | 이상윤 외 2인 15.54% |

Price & Relative Performance



Stock Data

| 주가수익률(%) | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
|----------|------|------|------|
| 절대주가 | 84.4 | 63.9 | 35.0 |
| 상대주가 | 71.7 | 42.6 | 15.4 |

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

1 기업 개요 및 연혁

창립 초기 머신비전 기술을 기반으로 반도체 전자부품의 외관 검사 장비를 개발

인텍플러스는 1995년 10월, 한국과학기술원(KAIST) 출신 연구원들이 창립한 검사 장비 전문 기업이다. 창업 초기부터 머신비전 기술을 기반으로 반도체 전자부품의 외관 검사 장비를 개발해왔으며, 고속 영상처리·정밀 제어·자동화 설계 등 다양한 요소 기술을 내재화하면서 검사 장비 국산화에 성공하였다. 설립 이후 지속적인 기술 고도화와 글로벌 고객사 확보에 힘입어 2011년 1월 코스닥 시장에 상장했고, 현재는 반도체 패키징 및 기판 검사 장비, 디스플레이 검사 장비, 이차전지 외관 검사 장비 등 다각화된 포트폴리오를 갖춘 기업으로 자리매김했다.

인텍플러스의 성장 과정은 크게 세 가지 궤적으로 나눌 수 있다. 2004년, 삼성전자에 반도체 패키징 외관 검사 장비를 공급하며 본격적인 반도체 검사 장비 사업에 진입했다. 당시 글로벌 시장은 미국 KLA(COS) 등 일부 기업이 독점하다시피 했으나, 인텍플러스는 독자적인 3D 측정 및 다면 검사 기술을 확보하면서 대체 공급자로 자리잡았다. 2007년에는 삼성전기에 반도체 기판 검사 장비를 납품하며 미드엔드 영역으로 사업을 확장하였으며, 이후 백색광 간섭계(WSI) 기반 기판 검사 장비가 글로벌 표준으로 채택되면서 유니마이크론(대만), 난야(대만), AT&S(오스트리아), 이비텐(일본), 신코(일본) 등 세계 주요 기판 업체들과 거래를 확대했다.

2010년대 이후, 디스플레이 및 이차전지 사업으로 외연을 넓혔다. 디스플레이 분야에서는 2011년 삼성에 3D 외관 검사 장비를 납품하며 사업을 개시했고, 이후 폴더블 디스플레이 고객사로까지 공급망을 확장하였다. 이차전지 분야에서는 2017년 국내 메이저 셀 제조사의 파우치형 배터리 검사 프로젝트를 시작으로, 2018년 이후 본격적으로 양산 라인에 외관 검사 장비 및 비전 모듈을 공급하면서 안정적인 성장 기반을 마련했다.

이와 같은 인텍플러스의 기술 및 사업적 진화는 연구개발 중심 조직 구조에 기반한다. 전체 인력의 약 50%가 R&D 인력으로 구성되어 있으며, 축적된 특허는 200여 건에 이른다. 인텍플러스의 머신비전 원천 기술은 2D/3D 정밀 측정, 딥러닝 기반 불량 탐지, 대면적 및 다면 검사까지 확장되어 반도체부터 2차전지에 이르는 첨단 제조업 전반에 응용되고 있다. 특히 고성능 구현을 위한 영상처리 기술과 고속 제어 기술을 자체 내재화해, 고객 맞춤형 커스터마이징이 가능한 것이 회사의 강점으로 꼽힌다.

2024년 연결 기준 매출 구성은 반도체 검사 장비가 약 45%, 디스플레이 및 이차전지 검사 장비가 약 55%를 차지한다. 전통적으로 반도체 부문이 회사의 주력 매출원이었으나, 글로벌 반도체 업황 둔화 속에서 최근에는 이차전지 사업이 안정적인 성장 축으로 부상하며 사업 포트폴리오의 균형을 맞추는 역할을 하고 있다. 특히 국내 메이저 셀 제조사 2곳을 고객으로 확보해 육안 검사에서 자동화 검사로의 전환 수요를 선점한 점은 안정적 수주를 뒷받침하고 있다. 디스플레이 부문은 폴더블 및 OLED 고객사를 기반으로 일정 매출을 창출하지만, 산업 특성상 투자 변동성이 커 매출 기여도는 제한적이다.

지역별로는 과거 중국·대만 등 중화권 비중이 절대적이었으나, 미·중 무역 분쟁과 현지 투자 둔화로 최근 축소되는 추세다. 대신 미국·일본 고객사 매출이 확대되며 성장 축이 다변화되고 있다. 인텍플러스는 미국, 대만, 중국에 현지 지사를 운영하며 Top-tier 고객사와의 접점을 넓히고 있다. 2차전지 분야에서는 국내 독점 납품 기반을 바탕으로 해외 생산 라인 진출을 모색하며, 반도체 부문에서는 글로벌 패키징 업체들과의 협업을 통해 첨단 패키징 검사 장비 공급사로써 위상을 강화하고 있다.

최근 주주구성을 살펴보면, 2025년 6월 30일 기준 최대주주는 이상윤 대표이사(874,678주, 6.80%)이며, 최이배(6.48%), 김재호(2.27%) 등 특수관계인을 포함한 지분율은 15.55%다.

사업 구조 및 주요 제품

반도체 검사 장비 (외관 검사 및 미드엔드 검사)와 디스플레이·이차전지 검사 장비로 구분

인텍플러스의 사업 구조는 크게 반도체 검사 장비(외관 검사 및 미드엔드 검사)와 디스플레이·이차전지 검사 장비로 구분된다. 창립 초기에는 반도체 패키징 외관 검사 장비에 집중해왔으며, 이후 기판 검사 장비, OLED 및 배터리 검사 장비로 사업 영역을 확대하면서 전방 산업의 투자 사이클과 함께 성장해왔다. 각 사업부문은 고객사 투자 방향과 기술 변화에 따라 매출 변동성이 존재하지만, 공통적으로 머신비전 기반 외관 검사라는 원천 기술을 바탕으로 한다는 점에서 기술적 일관성을 지닌다.

1) 외관 검사 장비(패키징 검사): 2024년 매출 비중 35%

인텍플러스의 핵심 사업은 반도체 패키징 공정에서 최종 출하 단계에 필요한 외관검사 장비다. 이 장비는 패키지 불량을 탐지하기 위해 2D·3D 측정 기술을 활용해 높이·깊이, 이물, 레이저 마킹 불량을 판별하며, 직육면체 형태의 반도체 패키지를 여섯 면 모두 직접 검사할 수 있는 차세대 기술을 확보한 것이 특징이다. 이러한 기술력은 글로벌 선두업체인 KLA(ICOS)와의 경쟁 구도에서 인텍플러스가 차별화된 입지를 확보하는 배경이 된다. 기존 제품 포트폴리오는 패키지 검사(PIS 시리즈), 메모리 모듈 검사(MAS 시리즈), SSD 검사(SSD 시리즈)로 구성되며, 최근에는 측면 검사와 Top면 3D 검사를 추가한 신모델(iPIS-580HX, iPIS-340HX 등)을 개발하면서 검사 항목과 정밀도를 확장했다. 또한 딥러닝 기반의 불량 판별 기능을 접목해 제한된 데이터로도 정교한 결함 검출이 가능하도록 고도화했다는 점도 중요한 진전이다.

고객사는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 메모리 IDM뿐 아니라, 대만 ASE·중국 화천과기·CXMT 등 해외 OSAT 고객사까지 폭넓게 분포한다. 특히 2025년 상반기 중 대만 최대 OSAT 기업인 A사를 통해 차세대 외관검사 장비가 퀄리피케이션 테스트를 통과하며 본격적인 매출 반영이 확정되었고, 2025년 9월 대만 글로벌 파운드리 T사의 CoWoS 패키징 라인에도 데모 장비가 투입되어 퀄리피케이션이 시작되었다. 북미 대형 IDM 고객사와는 대면적 패키징 검사를 위한 신규 프로젝트를 공동으로 진행 중이며, 전기차 및 AI/HPC 패키징 영역으로 활용 범위가 확장될 가능성이 크다.

이처럼 인텍플러스의 외관검사 장비는 기존 AOI(Automated Optical Inspection) 수준을 넘어, 차세대 메모리 모듈(SOCAMM) 대응과 CoWoS·하이브리드 본딩 등 첨단 패키징 공정으로까지 적용 범위를 넓히고 있다. 이에 따라 평

균판매단가(ASP) 상승과 신규 공정 레퍼런스 확보가 동시에 진행되며, 향후 2025~2026년 회사 실적 성장의 주력 드라이버로 자리할 전망이다.

2) 미드엔드 검사 장비(기판 검사): 2024년 매출 비중 10%

인텍플러스의 또 다른 핵심 축은 반도체 미드엔드 공정에서 활용되는 기판 검사 장비다. 미드엔드 공정은 전공정만큼이나 정밀도가 요구되는 영역으로, 반도체 칩을 기판에 연결하기 위한 범핑(Bumping)과 RDL(Redistribution Layer) 형성 과정에서 발생할 수 있는 결함을 탐지하는 역할을 한다. 인텍플러스는 백색광 간섭계(WSI) 기술과 3차원 측정 기술을 접목하여 솔더 범프의 높이, 균일성, 휨 현상, 공면점(Coplanarity)까지 정밀하게 검출할 수 있는 장비를 개발해 왔다. 이러한 기술력은 글로벌 고객사의 까다로운 품질 요건을 충족시키며, 인텍플러스 장비가 다수 고객사에서 사실상의 표준 장비로 채택되는 계기가 되었다.

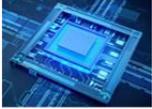
회사는 2000년대 초반 CSP 기판 검사 장비로 미드엔드 시장에 진입했으며, 2016년에는 북미 글로벌 반도체 고객사의 FC-BGA용 기판 외관 검사 장비를 공급하며 세계적 경쟁력을 입증했다. 2024년 8월에는 TSMC에 FC-BGA 기판 검사 장비("ISIS-NTV")를 공급하며, 기판사가 아닌 파운드리에 직접 장비를 납품하는 이례적 성과를 기록했다. 이는 TC본딩 전환을 대비한 연구개발 협력 성격으로, 향후 대규모 양산 수주 가능성을 열어두는 포석으로 평가된다.

현재는 AI 및 HPC 수요 확대와 함께 FC-BGA 기판의 대면적화·고사양화 트렌드가 뚜렷해지면서, 기존 장비로는 대응이 어려운 신규 니즈가 발생하고 있다. 인텍플러스는 대만 T사와 협업해 차세대 대면적 기판 검사 장비를 공동 개발 중이며, 해당 장비는 기존 장비 교체 수요뿐 아니라 AI 가속기+HBM 패키징용 신규 라인 투자에 따른 장비 도입 수요까지 선점할 수 있다는 점에서 의미가 크다. 특히 현재 차세대 대면적 기판 검사를 구현할 수 있는 업체는 인텍플러스 외에는 사실상 존재하지 않아, 독점적 기술 지위를 확보한 상황이다.

주요 고객군은 삼성전자와 같은 IDM뿐 아니라, 대만·중국·일본의 FC-BGA 기판사 등 글로벌 패키지 기판 업체들로 구성된다. 최근의 HPC 및 AI 인프라 확산에 따라 대형 기판 수요가 급증하면서, 인텍플러스의 미드엔드 검사 장비는 향후 몇 년간 신규 성장의 또 다른 축으로 자리매김할 전망이다. 일본 이비덴과 신코, 삼성전기 신규 라인에도 납품이 시작되었으며, 글로벌 기판 검사 장비 시장에서 인텍플러스의 점유율은 약 70~80%로 추정된다.

3) 디스플레이 및 이차전지 검사 장비: 2024년 매출 비중 55%

디스플레이 분야는 2011년 삼성의 3D 외관 검사 장비 납품으로 시작되었으며, 이후 폴더블 디스플레이 협력사와 BOE 등으로 고객 기반을 확대했다. 다만 전방 산업의 투자 변동성이 큰 특성상 매출 규모는 제한적이며, 2024년에도 약 50억 원 수준에 그쳤다. 이차전지 분야는 2017년 파우치형 배터리 셀 검사 프로젝트를 계기로 본격화되었으며, 국내 메이저 셀 제조사 두 곳을 주요 고객사로 확보했다. 기존 육안 검사를 자동화 검사로 전환하는 흐름 속에서 인텍플러스의 장비는 공정 안정성과 수율 확보에 기여하고 있다. 최근에는 외관 검사 장비와 비전 모듈 매출이 균형을 이루며 성장을 견인하고 있으며, 국내 독점 납품을 기반으로 해외 생산 라인 진출도 추진 중이다.

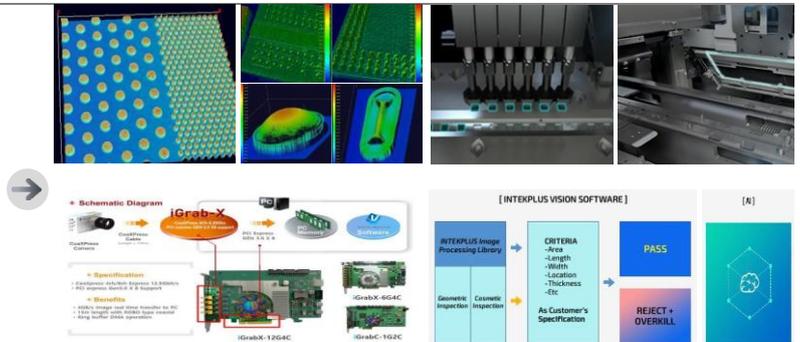
| 반도체 PKG | 반도체 MID-END | Display & 2차 전지 | Smart Factory |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Major 고객사 진입, Advanced PKG 검사 솔루션 공급 Advanced PKG 중심 TOP Tier 고객사 대응 | <ul style="list-style-type: none"> 주요 BGA 기판 고객사 대응, 차세대 BGA 시장 선점 Micro bump 검사 기술 차별화 지속, 신규 고객사 확보 | <ul style="list-style-type: none"> 비전 모듈 공급 및 2차 전지 주요 고객사 증설 대응 2차 전지 외관 검사 및 비전 모듈 Global site 공급 | <ul style="list-style-type: none"> Smart Factory 관련 외관 검사 솔루션 공급 자동차 생산라인의 검사공정 자동화를 위한 프로젝트 진행 |
|  Advanced Package  AI Deep Learning |  FC Substrate  Bumped Wafer |  2차 전지 외관 검사  자동차 면품질 검사 |  3D Sensor |
| Advanced PKG 검사분야 확대 | 반도체 Mid-end 분야 차세대 BGA 시장 선점 | 2차 전지 외관 검사 Global 통합 솔루션 제공 | Smart Factory / 검사자동화 산업 분야 확대 |

자료: 인텍플러스, 한국R협회의 기업리서치센터

인텍플러스의 핵심 기술력

One Source Multi Use

- 고속 3D 형상 측정 기술
- 영상처리 및 AI 알고리즘
- 자동화 제어 기술
- 디지털 신호 처리 기술



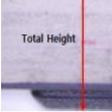
자료: 인텍플러스, 한국R협회의 기업리서치센터

반도체 Advanced PKG 검사 영역

Top Package Processing Trends

Advanced PKG – Heterogeneous Integration

Top Inspection Challenges in Advanced packages

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
|  Micro Crack |  Burr |  Total Height |  Underfill |  Dense Area |
|---|--|--|---|--|

자료: 인텍플러스, 한국R협회의 기업리서치센터

FC-BGA 범프 검사 솔루션

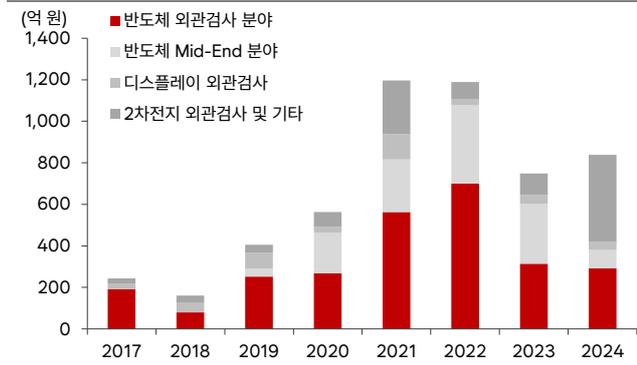
3D Solution for FC-BGA Bump Inspection

Most Precise 3D measurement Real 3D inspection for Flip Chip Package

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">  Yield improvement  Fine-pitch inspection  Accuracy and Precision | <ul style="list-style-type: none"> • Bump Height/ Coplanarity • Chip Attach-area Warpage • Bump Diameter/ offset • Thickness Variation • Bump damage • Bridge/ Missing bump • Scratch |
|---|--|

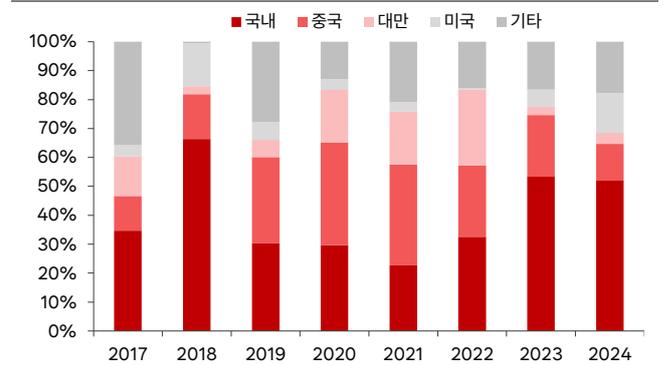
자료: 인텍플러스, 한국R협회의 기업리서치센터

사업부문별 매출 비중 추이



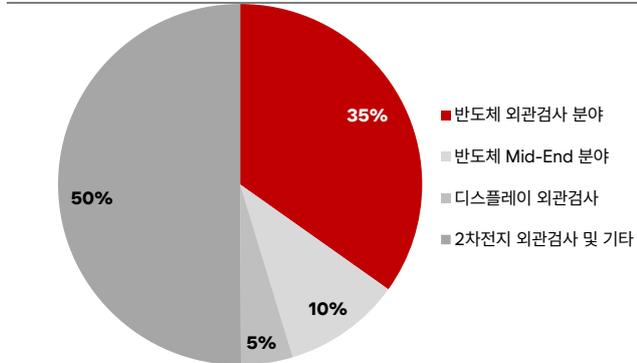
자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

지역별 매출 비중 추이



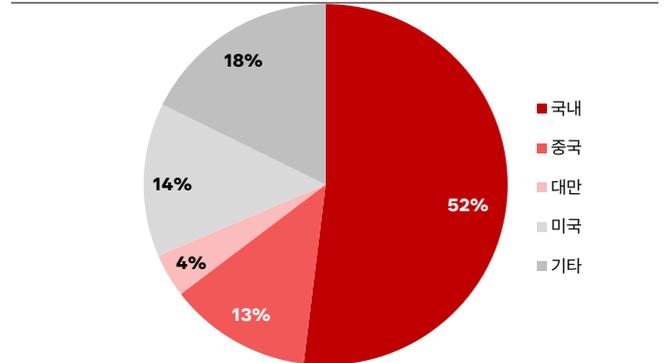
자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

2024년 연간 기준 사업부문별 매출 비중



자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

2024년 연간 기준 지역별 매출 비중



자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

 **산업 현황**

AI 수요로 인한 후공정 병목과 CapEx 투자 확대

**첨단 후공정 패키징 시장은
2024년 450억 달러에서
2030년 794억 달러로
연평균 10% 이상 성장**

AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요의 폭발적 증가는 반도체 후공정(전공정에서 제조된 칩을 패키징·검사하는 단계) 시장의 성장을 견인하는 동시에, 공급망 전반에 심각한 병목을 야기하고 있다. 시장조사기관 Yole Group은 2025년 글로벌 반도체 시장 규모가 AI 인프라 확산을 배경으로 전년 대비 17.6% 성장하여 약 6,970억 달러에 이를 것으로 전망한다. 이 가운데 첨단 후공정 패키징 시장은 2024년 450억 달러에서 2030년 794억 달러로 연평균 10% 이상 성장이 예상된다. 특히 AI 가속기 및 GPU 채택 확대, 클라우드·데이터센터 인프라 증설, 칩렛 기반 아키텍처 확산이 핵심 동력으로 작용하여 통신·인프라 부문이 연평균 14.9%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 보인다.

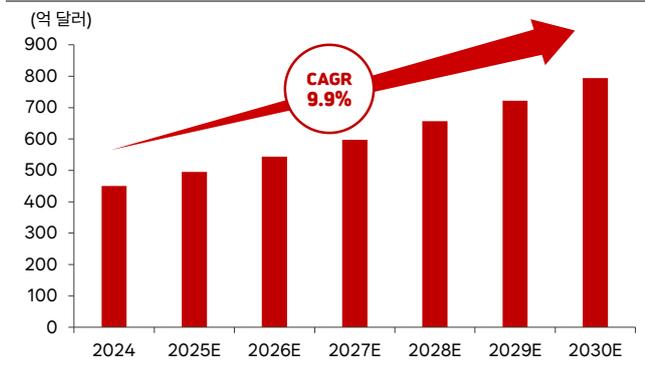
2024년 첨단 패키징 수요의 70%는 모바일·소비자 전자 부문에서 발생했으나, 향후 시장 성장축은 AI/HPC로 이동할 것으로 예상된다. CoWoS(대형 기판 위에 칩과 HBM을 적층하는 방식), SoC(여러 칩을 수직으로 쌓아 하나의 시스템 처럼 동작하게 하는 기술), EMIB(기판에 얇은 브리지를 삽입해 칩 간 고속 연결을 지원하는 기술), 3D 스택킹(칩을 다층 구조로 적층하는 방식) 등과 같은 차세대 패키징 기술이 주도할 것으로 판단된다. 이러한 기술들은 고대역폭·저지연 특성을 제공하지만, 동시에 공정 복잡성과 생산 병목을 심화시키는 요인으로 작용하고 있다.

실제로 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate) 생산 지연은 업계 전반의 가장 큰 병목으로 부상하고 있다. TSMC의 경우 2025년 CoWoS 공정의 병목률이 75%에 달할 것으로 추정되고 있다. 이는 인터포저(칩과 기판을 연결하는 중간층) 생산 한계, HBM 정렬 수율 저하, 열 관리 복잡성에서 기인한다. 예를 들어, CoWoS-L 패키지는 기존 대비 2배 큰 면적과 증가된 HBM 적층 수로 공정 시간이 2~3주에 달하며, 이는 공급망 전체를 압박한다.

이러한 병목은 파운드리와 OSAT 업체들의 대규모 설비 투자(CapEx)를 촉진한다. TSMC는 CoWoS 월간 용량을 2024년 3.5만장에서 2025년 말 7~8만장, 2026년 말 9~10만장으로 확대할 계획이며, 2025년 9개 신규 시설(8개 팹, 1개 첨단 패키징 플랜트) 건설이 예정되어 있다. 글로벌 OSAT 부문도 후공정 병목 해소를 위한 CAPEX를 대폭 확대 중이다. SEMI 보고서에 따르면, 2024년 후공정 장비 판매(CAPEX의 주요 지표)는 전년 대비 20.3% 증가했으며, 글로벌 OSAT 기업(ASE, Amkor, JCET)의 CAPEX는 총 11.9억 달러 규모로 2023년 대비 20% 성장했다. 2025년에도 AI 중심 용량 확대를 통해 20% 이상 추가 성장이 전망된다.

그러나 첨단 패키징 공정의 복잡성(예: TSV, 마이크로 범프, 다층 구조)으로 단순 용량 확장은 수율 안정화로 이어지지 않는다. 예컨대, HBM3-HBM3E와 같은 고단화 메모리 적층은 수천 개의 미세 범프 정렬과 열 방출 설계가 필요하며, 이는 결함 발생 가능성을 높인다. 이로 인해 검사 및 품질 관리 인프라의 수요가 기존 대비 2배 이상 증가하고 있으며, 전수 검사로 전환 수요가 본격화되고 있다. 병목 해소는 단순한 용량 증설을 넘어 공정 효율성 향상과 품질 관리 강화를 요구한다. 이러한 투자 확대는 AI 칩 수요를 충족하기 위한 필수 전략으로, 후공정 산업의 구조적 변화를 가속화하고 있다.

첨단 패키징 시장 전망



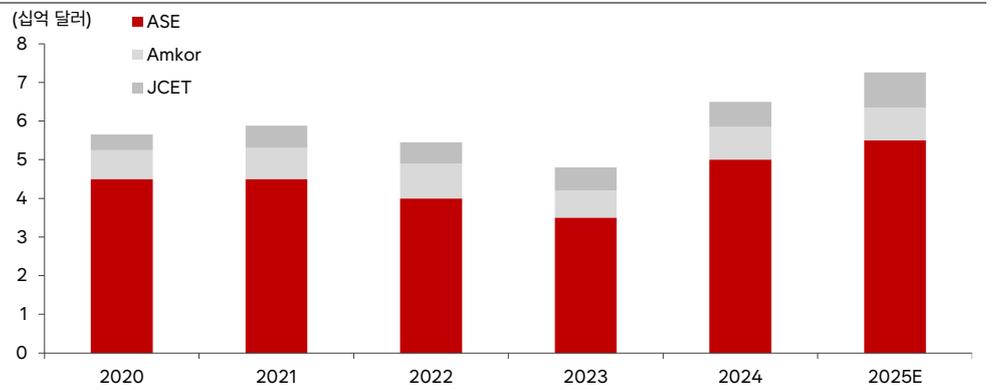
자료: Yole Group, 한국IR협회의 기업리서치센터

TSMC CoWoS 용량 확대 계획

| 시점 | 월간 CoWoS 용량 (장) |
|--------|------------------|
| 2024 년 | 30,000 ~ 35,000 |
| 2025 년 | 70,000 ~ 80,000 |
| 2026 년 | 90,000 ~ 100,000 |

자료: TSMC, 한국IR협회의 기업리서치센터

주요 OSAT 기업 CAPEX 추이



자료: Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

FC-BGA 기판 투자 사이클 재개

FC-BGA 패키지 기판은 AI/HPC 칩을 실장하는 데 필수적

첨단 패키징 공정은 크게 기판(미드엔드) 단계와 패키지 외관(후공정) 단계로 구분된다. 후공정 외관 검사가 완성된 패키지의 형상과 불량률 확인하는 단계라면, 미드엔드 공정은 그보다 앞단에서 패키징의 토대가 되는 기판의 품질을 보증하는 역할을 한다. 특히 FC-BGA 패키지 기판은 AI/HPC 칩을 실장하는 데 필수적이기 때문에, 첨단 패키징 수요 확대와 함께 기판 공정의 중요성은 급격히 높아지고 있다.

글로벌 IC 기판 시장은 2022~2023년 IT 수요 부진과 모바일·PC 중심의 범용 기판 의존으로 인해 큰 폭의 조정을 겪었다. 실제로 일본 이비덴(Ibiden), 신코(Shinko), 대만 유니마이크론(Unimicron) 등 주요 업체들은 이 시기 보수적인 CapEx 집행 기조를 유지하며 신규 증설을 미루었다. 그러나 2024년 하반기 들어 AI/HPC 수요가 본격적으로 부각되면서 업황 회복 신호가 가시화되고 있으며, 2025~2026년에는 대형 기판 업체들의 투자가 재개될 가능성이 높다. 최신 전망에 따르면, 글로벌 IC 기판 시장 규모는 2024년 147억 달러에서 2025년 167억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년까지 265억 달러에 달할 전망이다. 이 중 AI 서버용 FC-BGA 기판은 2023년 전체 수요의 3%에 불과했지만 2025년에는 20% 수준까지 확대될 것으로 추정된다.

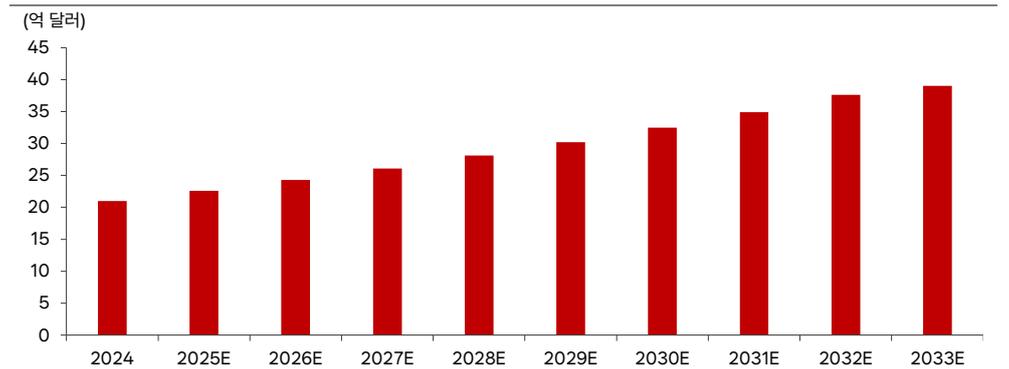
FC-BGA 패키지 기판은 CPU, GPU, HBM 등 고대역폭 메모리 패키징에 필수적으로 사용된다. AI 서버 및 HPC용 칩

은 기존 모바일·PC 대비 I/O 단자 수와 대역폭 요구치가 압도적으로 크기 때문에, 기판의 면적 확대와 고다층 구조가 불가피하다. 예컨대 HBM 패키징에서는 수천 개의 미세 범프를 기판과 연결해야 하며, 이러한 구조적 변화가 FC-BGA 수요를 견인한다. FC-BGA는 칩과 기판을 수천 개의 솔더 범프로 직접 연결하는 구조로, 미세 범프의 높이·균일성·정합성이 성능과 신뢰성을 좌우한다. AI/HPC 시대에는 FC-BGA 패키지 기판의 면적과 층수가 확대되며 검사 난도가 급격히 높아지고 있어, 정밀한 3D 검사 수요가 늘어나고 있다. FC-BGA 시장은 2024-2030년 CAGR 6.9%를 기록하며 2030년 143억 달러 규모로 성장할 전망이다.

인텍플러스는 FC-BGA 패키지 기판 영역에서 글로벌 레퍼런스를 확보하고 있다. 2016년에는 북미 글로벌 고객사로부터 FC-BGA용 기판 검사 장비를 표준 장비로 채택받았으며, 현재까지 글로벌 시장 점유율을 70~80% 수준에서 유지하고 있다. 또한 미국 및 아시아 주요 기판 제조사들과 협업하며, 대면적·고다층 검사 장비 공급 역량을 강화하고 있다. 2024년 8월에는 대만 글로벌 파운드리 업체(세계 점유율 60%, 530여 고객 보유)와 FC-BGA 기판 검사 장비(ISIS-NTV) 공급 계약을 체결하며 시장 입지를 더욱 공고히 했다.

탐티어 기판 업체들의 최근 실적 발표에서도 이러한 기류가 확인된다. 일본 이비덴은 2024년 3분기 실적 컨퍼런스에서 AI/HPC 수요 회복에 대응한 신규 CapEx를 2025년부터 확대할 것이라고 밝혔으며, 구체적으로 AI 서버 IC 기판 생산 능력을 40% 증강하고, 신규 공장 건설을 통해 2025년 말 25% 용량 가동을 시작할 계획이다. 유니마이크론은 2025년 CapEx를 전년 대비 30% 이상 상향할 계획이며, 삼성전기는 AI 서버용 FC-BGA 라인 증설을 공식화하며 2025년 영업이익 1조 원 목표를 제시했다. 신코 일렉트릭은 2025년 하반기부터 Takamori 신규 공장 가동을 통해 AI/HPC 기판 생산을 본격화할 예정이다. 이처럼 글로벌 탐티어 업체들의 FC-BGA 기판 투자가 재개된다는 것은 곧 기판 업황이 다시 성장 국면에 진입하고 있음을 의미하며, 이 과정에서 검사 장비 수요가 선행적으로 발생할 가능성이 크다.

FC-BGA 패키지 기판 시장 전망



자료: IMARC Group, 한국IR협의회 기업리서치센터

패키지 기판 증설 현황

| 기판 공급사 | 최신 증설 및 투자 내용 |
|------------------------------|---|
| Ibiden (일본) | <ul style="list-style-type: none"> AI/서버 IC substrate 수요 대응 위해 생산능력 40% 증강 계획 Gifu현 신규 공장 건설 중, 2025~2026년 일부 양산 시작 예정 |
| Shinko (일본) | <ul style="list-style-type: none"> Chikuma/Nagano 플랜트에서 차세대 FC-BGA(i-THOP®) 양산 라인 구축 Arai Plant에 플라스틱 BGA 생산능력 2배 확대 (2024~2026) |
| Unimicron (대만) | <ul style="list-style-type: none"> NT\$300억 규모 투자, Advanced FC-substrate/ABF substrate 사업 확대 추진 AI/HPC 대응 설비 증설 계획 진행 중 |
| Kyocera (일본) | <ul style="list-style-type: none"> 유기/세라믹 복합 substrate 라인업 확대 해외 전사회 중심으로 FCBGA-ABF 기술 홍보, 신규 고객 확보 추진 (CapEx 규모 미공개) |
| 대덕전자 (한국) | <ul style="list-style-type: none"> 2025년 2Q AI 가속기용 MLB 양산 개시 2025년 3Q 자율주행/서버용 FC-BGA 신규 라인 확대 예정 생산능력: 2026년 매출 기준 4,000억 원 수준까지 확대 목표 |
| 삼성전기 (한국) | <ul style="list-style-type: none"> 서버/AI용 FC-BGA 전용 라인 증설 공시화 베트남 신공장 1.9조 원 투자, 2024년 6월 양산 개시 세종/부산사업장 추가 라인 증축(고급 FC-BGA 50% 비중 목표) 검토 중 |
| AT&S (오스트리아/말레이시아) | <ul style="list-style-type: none"> 말레이시아 신규 ABF substrate 라인 증설 진행 중 double-sided buildup, ultra-thin core 등 첨단 구조 대응 설비 투자 |
| Zhen Ding Technology (대만) | <ul style="list-style-type: none"> Kaohsiung AI Park: ABF substrate/HDI 신규 설비 구축 2025년 NT\$80억 규모 ABF substrate 투자, NT\$20억 HDI 투자 태국 Prachinburi 신규 팹 2025년 하반기 가동 예정 |

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

3 병목 해소 과정에서 검사 장비 시장이 누릴 구조적 성장 기회

**첨단 패키징 기술의 확산은
기존 공정에서 관찰되지 않았던
새로운 결함 유형을 양산**

검사 장비는 더 이상 생산 라인의 최종 품질 보증 수단에 머물지 않는다. 첨단 패키징 시대의 병목은 단순한 생산능력 부족이 아니라 수율 저하에 있으며, 이를 해소하기 위한 핵심 인프라가 고해상도 계측·검사 장비다. 따라서 글로벌 반도체 기업들의 대규모 CapEx가 실질적인 효과를 발휘하기 위해서는 정밀 검사 장비의 동반 투자가 필수적이다. 실제로 글로벌 어셈블리·패키징 장비 지출은 2024년 +25.4%에 이어 2025년에도 +7.7%(54억 달러) 성장할 전망이다, 테스트 장비 역시 +23.2% 증가가 예상된다.

TSV, 마이크로 범프, 다층 기판 구조 등 첨단 패키징 기술의 확산은 기존 공정에서 관찰되지 않았던 새로운 결함 유형을 양산하고 있다. 미세 크랙, 정렬 불량, 열 관리 문제는 기존 AOI만으로는 탐지하기 어렵다. 특히 HBM3 패키징은 검사 포인트가 기존 대비 두 배 이상으로 늘어나면서, 3D 계측 다면 검사·AI 기반 패턴 분석 장비의 수요가 구조적으로 확대되고 있다.

글로벌 벤더들은 이미 AI 알고리즘을 접목한 고성능 검사 장비로 대응 중이다. KLA(미국)는 Advanced Packaging 영역 성장을 FY24 컨퍼런스에서 직접 언급했으며, 설치 기반 확대로 서비스 매출이 23억 달러(+10% YoY)에 달했다. Camtek(이스라엘)은 HBM 및 FC-BGA 검사 수요 증가에 힘입어 2025년 1Q 가이던스를 +23% YoY로 제시했고, 2Q 매출 역시 +20% YoY 성장했다. Onto Innovation(미국)은 Dragonfly 3Di 장비를 통해 2025년 2Q에만 20대 이상을 출하하며 HBM/2.5D 검사 수요를 빠르게 흡수하고 있다.

이와 동시에 글로벌 파운드리와 OSAT 업체들은 특정 벤더 의존도를 완화하기 위해 Second source 전략을 강화하고 있으며, 북미·유럽 지역에서도 지정학적 리스크 완화를 위한 첨단 패키징 CapEx 투자가 본격화되고 있다. 이에 따라 신규 검사 장비 업체의 시장 진입 기회가 확대되는 국면이다.

국내 업체인 인텍플러스는 FC-BGA 및 고다층 기판 검사 장비 분야에서 글로벌 레퍼런스를 확보하고 있다. 특히 대면적·고다층·커스터마이즈 장비라는 니치 경쟁력을 기반으로 글로벌 세컨 벤더 전략의 직접적인 수혜가 가능하다. 2024년 대만 파운드리와 체결한 ISIS-NTV 공급 계약은 이러한 경쟁력을 입증하는 사례로, 글로벌 CapEx 사이클과 직접적으로 맞물려 있다.

향후 2025~2026년 HBM 증설 사이클, CoWoS·SoIC·EMIB 라인 증대, 패키지 및 기판 동시 증설이 검사 장비 업계의 핵심 축매로 작용할 전망이다. 동시에 글로벌 고객사의 공급망 리스크 관리 차원에서 Second source 확대가 지속되며, 북미·유럽 보조금 정책에 힘입은 지역 다변화 투자 역시 성장 기회를 열어줄 것으로 기대한다.



투자포인트

FC-BGA 글로벌 1위 지위, 기판 투자 사이클 재개와 함께 턴어라운드 본격화

대면적·고정밀 3D 계측이 가능한
차세대 기판 검사 장비를
독자적으로 공급할 수 있는
사실상 유일한 기업

AI 서버와 HPC 칩 수요 확산으로 기판 면적이 대형화되고 고다층 구조가 일반화되면서 검사 난이도는 급격히 높아지고 있다. 인텍플러스는 대면적·고정밀 3D 계측이 가능한 차세대 기판 검사 장비를 독자적으로 공급할 수 있는 사실상 유일한 기업으로, 글로벌 기판사들의 투자 재개와 맞물려 시장 반등의 직접적인 수혜가 예상된다.

인텍플러스는 FC-BGA 검사 장비 시장에서 글로벌 점유율 70~80%를 차지하며 사실상 1위 사업자로 자리매김하고 있다. FC-BGA 검사 장비는 엔드 고객사가 직접 지정하는 경우가 많아 진입 장벽이 높은 영역인데, 인텍플러스는 2016년 북미 글로벌 고객사 표준 장비 채택을 시작으로 대만·미국·한국 주요 기판사에 꾸준히 납품하며 입지를 공고히 해왔다. 최근에는 LG이노텍을 비롯한 국내 고객사뿐만 아니라 일본 토틀어 기판사와의 신규 수주를 확보했고, 2024년 8월에는 세계 최대 파운드리인 TSMC와 차세대 FC-BGA 기판 검사 장비 퀄리티케이션을 통과하여 글로벌 최상위 고객사까지 레퍼런스를 확장하는 데 성공했다.

이와 함께, 북미 주요 고객사가 수주한 북미 전기차 업체의 AI 칩 패키징 프로젝트에서 인텍플러스의 참여 가능성이 높아지고 있다. 해당 프로젝트는 기존 대비 훨씬 대형화된 기판 검사가 요구되는데, 인텍플러스는 이를 대응할 수 있는 사실상 유일한 벤더사이다. 이미 북미 고객사의 표준 벤더로서 오랜 레퍼런스를 확보한 만큼, 해당 프로젝트에서 단독 공급사로 수주할 가능성이 크다. 인텍플러스가 FC-BGA 기판 검사 1위 지위를 넘어, 차세대 패키징 검사 시장으로 영향력을 확장하는 계기가 될 전망이다.

첨단 패키징 영역(CoWoS-HBM) 진입으로 성장 궤도 본격화

첨단 패키징 검사 영역(CoWoS,
차세대 메모리, HBM/하이브리드
본딩)까지 확장

FC-BGA 검사 장비 시장에서 글로벌 1위 지위를 확보한 인텍플러스는, 이제 그 기술적 기반을 바탕으로 첨단 패키징 검사 영역(CoWoS, 차세대 메모리, HBM/하이브리드 본딩)까지 확장하고 있다. AI/HPC 시대의 핵심 공정에서 새로운 성장 모멘텀을 확보하는 과정으로 평가된다.

CoWoS 패키징 검사 장비 시장은 TSMC가 KLA를 단일 벤더로 채택해왔지만, 생산능력이 2024년 3.5만 장/월에서 2026년 10만 장/월로 급증하면서 일부 공정을 OSAT에 위탁해오고 있다. 인텍플러스는 OSAT과 협력해 2025년 9월 CoWoS 데모 검사 장비를 선적하였다. 6개월 이내 퀄리티케이션을 완료할 경우, 2026년부터 본격적인 양산 수주가 기대된다. 특히 OSAT 단계에서 안정적인 레퍼런스를 확보할 경우, 향후 TSMC로의 직납 가능성도 열려 있어 글로벌 첨단 패키징 생태계 내 입지를 확대할 수 있는 전략적 기회가 될 전망이다.

인텍플러스의 차세대 메모리 외관 검사 장비도 본격적인 성장을 앞두고 있다. 6면 외관 검사에 크랙 탐지까지 가능한 차세대 외관검사 장비는 기존의 다면·3D 계측 기반 iPS 플랫폼을 업그레이드한 형태로, HBM·차세대 메모리 패키징 라인 적용을 염두에 두고 개발되었다. 2024년부터 국내 주요 반도체 고객사에 납품되며 이미 상용 레퍼런스를 확보했으며, 2025년 6월에는 대만 최대 OSAT 기업의 퀄리티케이션을 통과했다. 이에 따라 2025년 하반기부터 양산 매출

이 반영되기 시작해, 2026년에는 회사 실적 성장의 핵심 동력으로 자리매김할 전망이다.

HBM 공정은 현재 공급 부족으로 인해 검사 장비 도입보다는 적시 생산에 집중되는 상황이다. 이에 따라 전수검사 수요는 아직 제한적이지만, 인텍플러스는 국내 메모리 고객사들과 공동 개발 협의를 진행하며 HBM 전용 모듈을 접목한 신규 장비 개발을 추진하고 있다. 현실적인 매출 인식 시점은 2026년 이후로 예상되며, 이는 HBM 시장의 안정화 및 검사 공정 전환 속도에 달려 있다.

또한, 차세대 하이브리드 본딩(웨이퍼 투 웨이퍼) 공정에 대응하는 검사 장비를 국책과제와 연계해 개발 중이다. 하이브리드 본딩은 업계에서 빠른 시간 내 상용화가 기대되는 기술로, 관련 장비 시장이 열릴 경우 인텍플러스의 신규 성장 축으로 연결될 가능성이 높다.

인텍플러스는 기판 검사 장비에서 글로벌 1위 지위를 기반으로, CoWoS·차세대 메모리·HBM/하이브리드 본딩이라는 첨단 패키징 신영역으로 성장 무대를 넓히고 있다. 이는 구조적으로 다층적 성장 레버리지를 의미한다. 기판 투자 사이클 재개와 더불어 첨단 패키징 장비 매출이 순차적으로 반영될 경우, 인텍플러스는 2025~2026년을 기점으로 실적 턴어라운드와 멀티플 리레이팅을 동시에 달성할 수 있는 위치에 있다.

3 비용 구조 개선과 이익 레버리지: 수익성 회복의 모멘텀

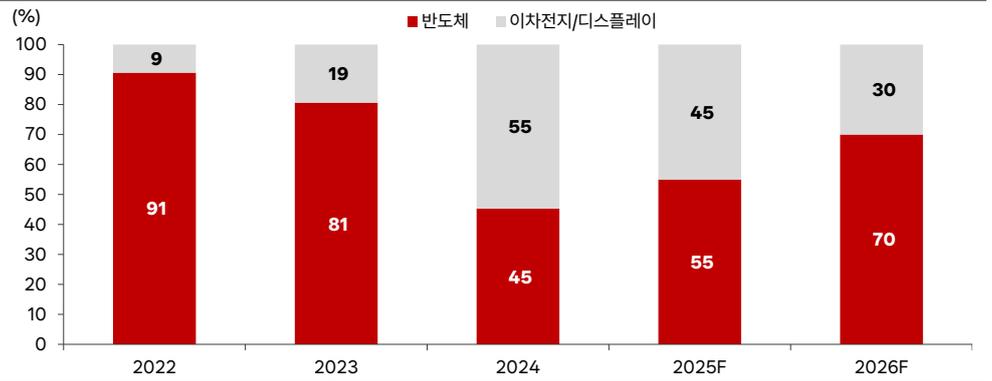
2025년 들어 구조조정 효과가 본격화되어 약 70~80억 원 수준의 인건비 절감 효과가 발생

최근 몇 년간 인텍플러스의 실적이 부진했던 이유는 단순히 산업 사이클 둔화 때문만은 아니었다. 신규 사업 확대를 위해 인력을 200명대 중반에서 300명 후반까지 급격히 늘렸고, 이로 인해 고정비 부담이 크게 확대되었다. 여기에 이차 전지 검사 장비의 초기 사이트 진입 비용(샘플 납품, 설치, 커스터마이징 등)까지 겹치며 2023~2024년에는 마진율이 크게 훼손되었다. 실제로 2022년까지 매출의 90% 이상이 반도체 장비에서 발생했으나, 2023년 업황 둔화로 반도체 매출액이 전년 대비 44% 감소했고, 매출 비중은 2024년 45%까지 축소되었다.

그러나 2025년 들어 구조조정 효과가 본격화되고 있다. 인텍플러스는 2024년 연말부터 약 100여 명의 인력을 감축하여 인건비 부담을 줄였으며, 2025년 상반기 말 기준 261명의 효율적인 인력 구조를 유지하고 있다. 이에 따라 연간 약 70~80억 원 수준의 인건비 절감 효과가 발생할 것으로 추정되며, 분기 BEP 매출도 하향 조정되어 매출 증가에 따른 영업 레버리지 상승 기반이 마련되었다.

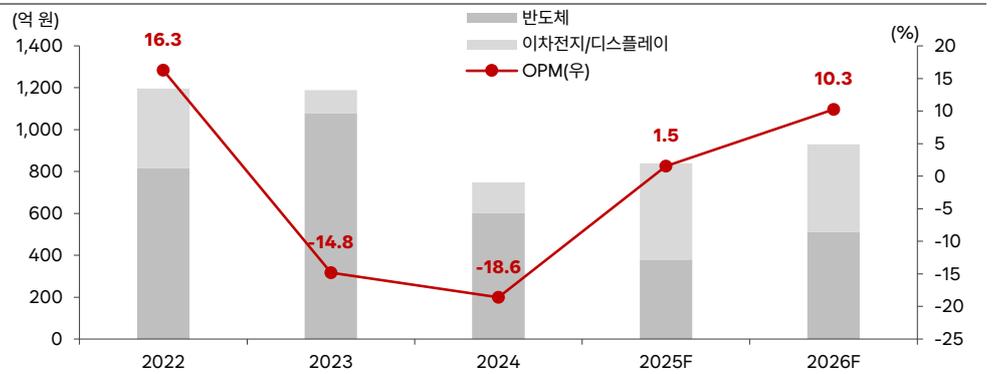
동시에 매출 구조에서도 반도체 비중이 확대되고 있는데, 이는 단순한 사이클 반등이 아니라 첨단 패키징(CoWoS·하이브리드 본딩) 및 FC-BGA 기판 검사 수요 확대라는 구조적 성장 요인에 기반한다. 반도체 장비는 이차전지 대비 평균 마진율이 높아 매출 믹스 개선 자체가 수익성 회복을 이끈다. 2025년 반도체 매출 비중은 55%로 반등하고, 2026년에는 70%까지 확대될 것으로 예상된다. 이에 따라 영업이익률(OPM)도 2025년 흑자전환에 이어 2026년 두 자릿수 수준으로 반등할 전망이다. 결국 고수익성 사업 확대와 비용 구조 개선이라는 두 가지 요인이 맞물리면서, 인텍플러스의 이익 레버리지는 향후 2년간 뚜렷하게 나타날 것으로 예상된다. 이는 투자자 입장에서 실적 턴어라운드와 함께 멀티플 리레이팅으로 이어질 수 있는 핵심 모멘텀이다.

인텍플러스 사업부문별 매출 추이 및 전망



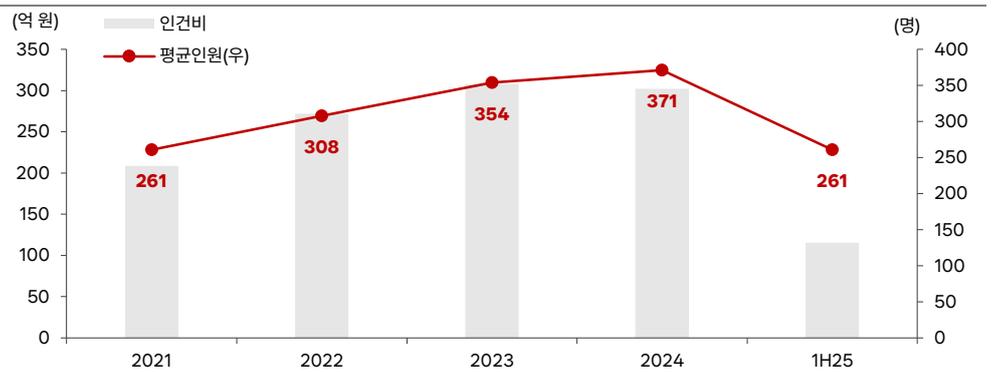
자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

인텍플러스 사업부문별 매출 비중, OPM 추이 및 전망



자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

인텍플러스 인건비, 평균인원 추이



자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

 **실적 추이 및 전망**

1 2025년 상반기 실적 리뷰

**2025년 상반기는
반도체 매출의 성장과 비용
구조 개선으로
2분기 흑자전환에 성공**

인텍플러스의 2025년 상반기 매출은 396억 원으로 전년 동기 418억 원 대비 5.4% 감소하였다. 그러나 세부 구성을 살펴보면 반도체 부문이 184억 원으로 전년 동기 169억 원 대비 8.5% 증가하며 비중이 41%에서 46%로 확대되었다. 반면, 디스플레이/이차전지 부문은 212억 원으로 전년 동기 249억 원 대비 14.8% 감소하여 비중이 59%에서 54%로 축소되었다. 전체 매출은 소폭 감소했으나 구조적으로 반도체 중심으로 재편되는 흐름이다.

수익성 측면에서는 개선이 두드러졌다. 매출총이익은 138억 원으로 전년 동기 117억 원 대비 18.6% 증가하였다. 반면 판관비는 167억 원으로 전년 동기 193억 원 대비 13.3% 감소하며 효율화가 나타났다. 이에 따라 영업손실은 -29억 원으로, 전년 동기 -76억 원 대비 적자 폭이 절반 이하로 축소되었다. 구조조정 효과와 비용 통제 기조가 본격적으로 반영된 결과로 판단된다.

분기별로 보면 1분기 매출은 144억 원으로 영업손실 -45억 원을 기록했으나, 2분기에는 매출 252억 원, 영업이익 16억 원으로 흑자전환에 성공하였다. 특히 2분기 반도체 매출은 147억 원으로 전분기(37억 원) 대비 큰 폭으로 확대되며 턴어라운드의 결정적 요인이 되었다. 매출총이익도 92억 원으로 판관비 76억 원을 상회하며 손익 구조가 안정화되는 모습이 확인되었다.

인텍플러스의 2025년 상반기는 외형 면에서 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 반도체 매출의 성장과 비용 구조 개선이 맞물리면서 손익 개선과 2분기 흑자전환이라는 의미 있는 전환점을 보여주었다. 이는 2025년 하반기 이후 반도체 중심 성장과 이익 레버리지가 본격적으로 가시화될 것임을 시사한다.

2 향후 실적 전망

**2025년 사업부문별 매출 비중은
반도체 55%,
디스플레이/이차전지 45%**

2025년 인텍플러스의 연간 매출은 930억 원으로 전년 대비 약 11% 성장할 것으로 예상된다. 사업 구조는 반도체 511억 원(비중 55%)과 디스플레이/이차전지 419억 원(비중 45%)으로 재편될 전망이다. 특히 반도체 부문은 패키징 외관 검사 장비가 전체 매출의 39%, 미드엔드 기판 검사 장비가 16%를 차지하며 고수익성 성장의 중심축이 될 것으로 보인다.

반도체 매출 성장은 글로벌 주요 고객사의 투자 재개와 신규 진입 효과가 동시에 작용한 결과다. 대만에서는 CoWoS 검사 장비 퀄리피케이션이 2025년 9월부터 진행되며, 초기 선적분이 연내 매출에 반영될 것으로 예상된다. 북미에서는 HPC 패키징 투자 확대에 맞춰 대면적 기판 검사 장비 공급이 상반기부터 시작되며, 단독 벤더 체제를 기반으로 안정적 매출 기여가 가능하다. 일본의 Ibiden과 Shinko 역시 신규 라인 증설에 나서고 있어, FC-BGA 검사 장비 수요가 확대될 것으로 보인다. 중국은 기존 OSAT 고객사 투자가 위축되었으나, CXMT 신규 진입을 통해 모듈·외관 검사 장비 매출이 보완적으로 더해지고 있다.

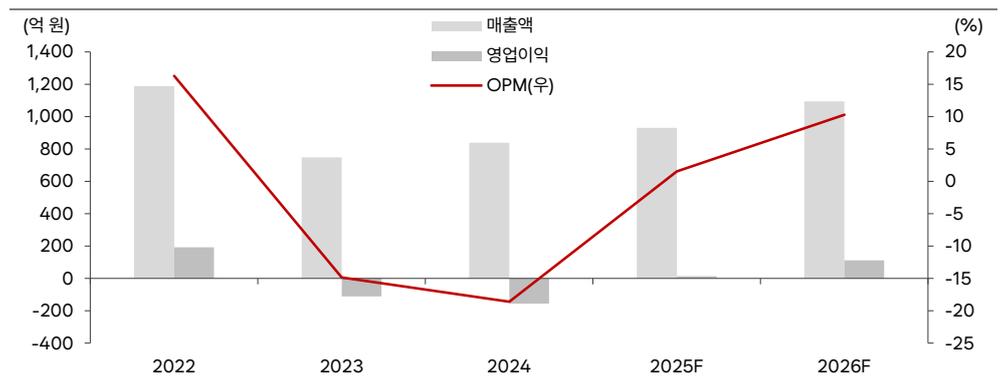
반면 디스플레이·이차전지 부문은 419억 원으로 전년 대비 14% 감소가 예상된다. 이차전지에서는 기존 국내 주요 고객사 두 곳에 대한 단독 공급 지위를 유지하고 있으며, 외관검사 장비와 비전 모듈 장비 매출이 각각 절반씩 차지하는 구조다. 신규 사이트 대응이 확대되고 해외 진입 가능성도 열려 있으나, 여전히 초기 설치와 커스터마이징 과정에서 발생하는 비용 부담이 크다는 점은 수익성 제약 요인으로 작용한다. 디스플레이 부문은 삼성 및 BOE 중심으로 매출이 발생하며, 폴더블 관련 협력 수요가 이어지고 있지만 전방 산업 변동성이 커 구조적 성장 동력은 제한적이다. 결과적으로 이차전지·디스플레이 부문은 안정적 매출원으로 기능하되, 수익성 개선을 이끌 주력 사업으로 보기는 어렵다.

비용 구조 측면에서는 고정비 축소 효과가 본격화되며 개선세가 나타나고 있다. 인건비 절감과 판관비 효율화가 반영되면서 매출총이익은 343억 원(YoY +40.1%), 판관비는 328억 원(YoY -18.0%) 수준으로 예상된다. 2분기 이후 반도체 매출 비중 확대가 가속화되고, 고정비 레버리지가 작동하면서 하반기부터는 수익성 개선 속도가 빨라질 것으로 예상된다. 이에 따라 영업이익은 14억 원으로 흑자전환할 전망이다, 영업이익률(OPM)은 1.5%로 추정한다.

2026년은 구조적 변화가 가시화되는 전환점이 될 전망이다. 매출은 1,094억 원으로 전년 대비 17.6% 증가하며, 이중 반도체가 766억 원으로 70%를 차지할 것으로 예상된다. 디스플레이·이차전지 매출은 328억 원으로 절대 규모는 유지되지만, 비중은 30%로 축소될 것이다. 반도체 중심 매출 믹스 전환에 따라 수익성은 크게 개선될 전망이다. 매출 총이익은 455억 원(+32.9% YoY), 영업이익은 112억 원으로 전년 대비 7배 이상 증가하며 영업이익률(OPM)은 10.3%까지 반등할 것으로 기대된다. 이는 글로벌 고객사의 첨단 패키징 투자 확대와 인텍플러스의 독점적 공급 지위, 그리고 고정비 절감 효과가 결합해 만들어내는 구조적 수익성 회복이다.

따라서 2026년은 인텍플러스가 단순한 업황 반등 기업을 넘어 첨단 패키징 검사 글로벌 표준 기업으로 재평가될 수 있는 시기로, 밸류에이션 리레이팅 가능성을 주목할 필요가 있다.

인텍플러스 실적 추이 및 전망



자료: 인텍플러스, 한국IR협의회 기업리서치센터

인텍플러스 실적 테이블

(단위: 억 원, %)

| 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025F | 2026F |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 매출액 | 1,188 | 748 | 839 | 930 | 1,094 |
| 반도체 | 1,078 | 603 | 380 | 512 | 766 |
| 디스플레이/2차전지 | 111 | 145 | 459 | 419 | 328 |
| 영업이익 | 194 | -111 | -156 | 14 | 112 |
| 영업이익률 | 16.3 | -14.8 | -18.6 | 1.5 | 10.3 |
| 지배주주순이익 | 163 | -108 | -119 | 20 | 123 |
| 지배주주순이익률 | 13.7 | -14.4 | -14.2 | 2.1 | 11.3 |
| YoY 증감률 | | | | | |
| 매출액 | 78 | 256.5 | 74 | 33.4 | 33.4 |
| 반도체 | 31.9 | -44.0 | -37.0 | 34.6 | 49.7 |
| 디스플레이/2차전지 | -70.8 | 30.8 | 216.3 | -8.7 | -21.6 |
| 영업이익 | -29.7 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | 685.8 |
| 지배주주순이익 | -27.9 | 적자전환 | 적자지속 | 흑자전환 | 518.4 |

자료: 인텍플러스, 한국IR협회의 기업리서치센터



Valuation

2026년 PER 18.8배

**현재 시가총액은 2,319억 원으로
2026년 예상 PER 18.8배,
PBR 3.8배 수준으로
글로벌 동종업체 대비 저평가 구간**

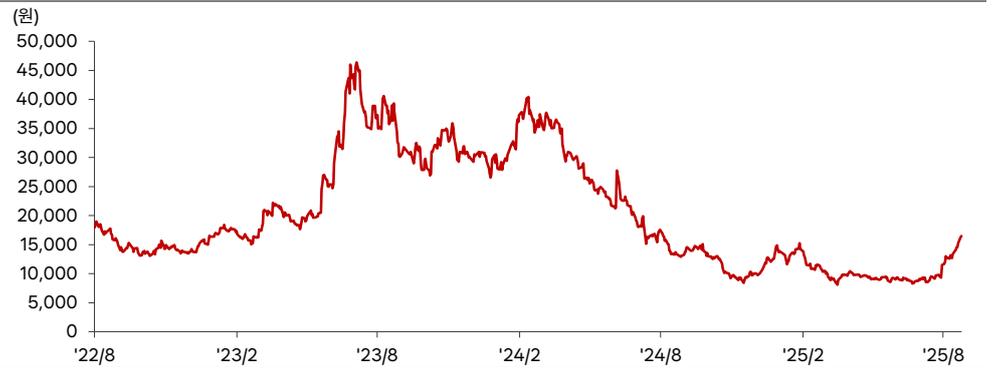
인텍플러스의 현재 시가총액은 2,319억 원으로 2026년 예상 PER 18.8배, PBR 3.8배 수준으로 글로벌 동종업체 대비 여전히 저평가 구간에 머물러 있다. Camtek(이스라엘, PER 25.6배, PBR 4.41배), Onto Innovation(미국, PER 20.7배, PBR 2.32배) 등 글로벌 Peer들은 첨단 반도체 검사 장비 시장에서 프리미엄 멀티플을 받고 있으며, 국내 동종업체 고영 역시 2026년 예상 PER 32.9배, PBR 2.91배로 평가받고 있다. 이에 비해 인텍플러스의 멀티플은 현저히 낮아, 업황 반등과 실적 정상화가 본격화될 경우 리레이팅 여력이 크다.

과거에도 시장은 인텍플러스의 성장 잠재력을 주목한 바 있다. 인텍플러스는 2023년 HBM·CoWoS 등 첨단 패키징 투자 확대 기대가 부각되면서 주가가 4만8천 원, 시가총액 약 6천억 원까지 상승한 바 있다. 다만 당시에는 실적 기여가 제한적이어서 밸류에이션의 지속성이 확보되지 못했고, 주가는 이후 조정을 받았다. 현재는 2025년 2분기 흑자 전환이 확인되었고, 하반기부터 반도체 부문 매출 비중이 본격적으로 확대되면서 연간 턴어라운드 가시화되고 있다. 과거의 기대가 선반영에 머물렀다면, 이제는 실적 개선과 펀더멘털 전환으로 현실화되는 단계에 진입했다고 평가된다.

근거는 다섯 가지다. 첫째, CoWoS 검사 장비가 실제 퀄리피케이션 단계에 들어서 단기적으로 양산 매출로 이어질 가능성이 커졌다. 둘째, 매출 포트폴리오가 중국에서 일본과 북미로 재편되며 지정학적 리스크가 완화되고 멀티플 할인 요인도 축소되고 있다. 셋째, FC-BGA 기판 검사 장비는 글로벌 표준으로 자리잡아 70~80%의 점유율을 유지하고 있으며, 이는 인텍플러스가 단순 니치 플레이어가 아니라 핵심 벤더임을 보여준다. 넷째, 인력 구조조정 효과로 고정비 부담이 줄어 매출 증가분이 곧바로 이익으로 연결되는 레버리지 구간에 들어섰다. 마지막으로, KLA 독점 체제 속에서 글로벌 고객사들이 세컨 벤더 확보를 강화하는 추세는 인텍플러스의 대체 공급자 지위를 강화하고 있다.

결론적으로 인텍플러스는 여전히 과거 침체기의 멀티플을 반영받고 있으나, 2025년을 기점으로 CoWoS 퀄리피케이션, 글로벌 고객 다변화, 비용 구조 정상화, 세컨 벤더 전략 등 구조적 변화 요인을 동시에 확보하고 있다. 이는 단순한 턴어라운드 기대를 넘어 멀티플 리레이팅을 정당화하는 근거이며, 동종 업계 내에서 가장 높은 업사이드 잠재력을 가진 후공정 검사 장비 업체로 평가된다.

인텍플러스 주가 추이



자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Peer Group 밸류에이션 비교

| 기업명 | 종가(₩) | 시가총액 (억 원) | 매출액(억 원) | | | 영업이익(억 원) | | | P/E(배) | | P/B(배) | |
|---------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | 2024 | 2025F | 2026F | 2024 | 2025F | 2026F | 2025F | 2026F | 2025F | 2026F |
| 코스피 | 3,413 | 27,329,483 | 37,538,806 | 30,108,916 | 31,627,564 | 2,495,513 | 2,841,039 | 3,414,003 | 12.7 | 10.7 | 1.13 | 1.04 |
| 코스닥 | 846 | 4,453,715 | 3,342,714 | 984,574 | 1,073,030 | 110,763 | 91,295 | 133,041 | 33.2 | 20.3 | 2.88 | 2.56 |
| 인텍플러스 | 17,250 | 2,219 | 839 | 930 | 1,094 | -155.9 | 14.3 | 112.3 | 116.4 | 18.8 | 4.8 | 3.8 |
| 팜트론 | 17,370 | 3,698 | 570 | 702 | N/A | -36 | 28 | N/A | 176.1 | N/A | 12.34 | N/A |
| 고영 | 15,200 | 10,436 | 2,025 | 2,254 | 2,590 | 33 | 165 | 301 | 63.7 | 32.9 | 3.11 | 2.91 |
| Camtek(이스라엘) | 89 | 56,132 | 5,851 | 6,807 | 7,376 | 1,473 | 2,094 | 2,291 | 28 | 25.6 | 5.06 | 4.41 |
| Onto Innovation(미국) | 116 | 78,445 | 13,458 | 13,772 | 15,012 | 2,550 | 3,475 | 3,956 | 23.7 | 20.7 | 2.68 | 2.32 |
| Takaoka Toko(일본) | 3,130 | 4,788 | 9,751 | 10,150 | 10,808 | 542 | 658 | 799 | 11.7 | 9.7 | 0.78 | 0.74 |

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

리스크 요인

고객사 투자 변동성 리스크

인텍플러스의 사업 구조는 글로벌 반도체 고객사의 투자 사이클에 강하게 연동된다. 특히 후공정 장비는 고객사의 신규 라인 증설 및 공정 전환 시기에 맞춰 발주가 집중되는 특성이 있다. 이 때문에 특정 분기 또는 연도에 고객사 CapEx가 지연되면, 수주잔고가 충분하더라도 매출 인식 시점이 밀리면서 실적 변동성이 확대될 수 있다. 2022~2023년 중국향 매출이 급격히 줄어든 사례는 이러한 구조적 한계를 잘 보여준다.

또한 북미 HPC 고객사처럼 단일 벤더 구조를 운영하는 경우, 공급 개시 여부 자체가 매출 레벨에 직접적인 영향을 준다. 단일 고객사 의존도가 높은 상황에서는 프로젝트 일정이 지연되거나 사양이 변경될 때 리스크가 더욱 커질 수 있다. 글로벌 반도체 장비 업황이 다시 둔화될 경우, 인텍플러스가 계획한 2025~2026년 턴어라운드 시점이 늦춰질 가능성도 배제하기 어렵다.

경쟁 심화 및 기술 검증 리스크

패키징 외관 검사 시장은 오랫동안 KLA(COS)가 사실상 독점해온 영역이다. 고객사들은 최근 세컨 벤더 확보 전략을 강화하고 있지만, 이는 인텍플러스가 반드시 퀄리피케이션을 통과해야만 실제 매출로 이어진다는 점을 의미한다. 특히 CoWoS-하이브리드 본딩과 같은 차세대 패키징 공정은 검사 항목의 난이도가 크게 증가하기 때문에, 검사 속도·정밀도·수율 등 기술 경쟁에서 우위를 입증하지 못할 경우 기대되는 성과가 제한될 수 있다.

더불어 일본 및 중국 로컬 업체들도 기판 검사 장비 경쟁에 뛰어 들고 있어, 향후 시장 진입장벽이 낮아질 가능성도 존재한다. 현재 인텍플러스가 보유한 글로벌 점유율은 기술 경쟁력을 방증하지만, 새로운 기술 패러다임 전환기에 접어들면 기존 장비의 표준화 지위가 흔들릴 수 있다. 따라서 고객사의 기술 검증 단계에서 성과를 내지 못할 경우, 밸류에이션 프리미엄을 정당화하기 어려워진다.

규모의 한계와 재무적 부담 리스크

인텍플러스는 국내외 Peer 대비 상대적으로 영세한 규모를 보유하고 있으며, 대규모 프로젝트 수주 시에도 연구개발·운전자본 확충 부담이 클 수밖에 없다. 2023~2024년 인력 급증으로 고정비 부담이 확대된 경험은, 다시금 공격적 투자가 필요한 국면에서 유동성 관리 리스크로 이어질 수 있다. 향후 대규모 고객사 수주가 본격화될 경우, 단기적으로는 실적 개선이 가능하지만, 프로젝트 집행 속도에 따라 현금흐름 불균형이 재현될 수 있다는 점은 감안해야 한다.

포괄손익계산서

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025F | 2026F |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 매출액 | 1,188 | 748 | 839 | 930 | 1,094 |
| 증가율(%) | -0.7 | -37.1 | 12.1 | 10.9 | 17.6 |
| 매출원가 | 672 | 520 | 594 | 588 | 639 |
| 매출원가율(%) | 56.6 | 69.5 | 70.8 | 63.2 | 58.4 |
| 매출총이익 | 516 | 228 | 245 | 342 | 455 |
| 매출이익률(%) | 43.4 | 30.5 | 29.2 | 36.8 | 41.6 |
| 판매관리비 | 323 | 339 | 400 | 328 | 343 |
| 판매비율(%) | 27.2 | 45.3 | 47.7 | 35.3 | 31.4 |
| EBITDA | 202 | -98 | -141 | 34 | 130 |
| EBITDA 이익률(%) | 17.0 | -13.1 | -16.8 | 3.6 | 11.8 |
| 증가율(%) | -28.9 | 적전 | 적지 | 흑전 | 282.3 |
| 영업이익 | 194 | -111 | -156 | 14 | 112 |
| 영업이익률(%) | 16.3 | -14.8 | -18.6 | 1.5 | 10.3 |
| 증가율(%) | -29.7 | 적전 | 적지 | 흑전 | 685.8 |
| 영업외손익 | -3 | 2 | 53 | 9 | 10 |
| 금융수익 | 65 | 31 | 111 | 64 | 67 |
| 금융비용 | 69 | 33 | 57 | 55 | 57 |
| 기타영업외손익 | 1 | 4 | -1 | -1 | -1 |
| 중속/관계기업관련손익 | -1 | -11 | -4 | -4 | -4 |
| 세전계속사업이익 | 190 | -120 | -107 | 19 | 118 |
| 증가율(%) | -31.7 | 적전 | 적지 | 흑전 | 515.4 |
| 법인세비용 | 26 | -12 | 11 | -1 | -5 |
| 계속사업이익 | 163 | -108 | -119 | 20 | 123 |
| 중단사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익 | 163 | -108 | -119 | 20 | 123 |
| 당기순이익률(%) | 13.7 | -14.4 | -14.2 | 2.1 | 11.3 |
| 증가율(%) | -27.9 | 적전 | 적지 | 흑전 | 518.4 |
| 지배주주지분 순이익 | 163 | -108 | -119 | 20 | 123 |

현금흐름표

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025F | 2026F |
|-----------------|------|------|------|-------|-------|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 69 | 17 | -73 | -11 | 47 |
| 당기순이익 | 163 | -108 | -119 | 20 | 123 |
| 유형자산 상각비 | 6 | 10 | 12 | 15 | 13 |
| 무형자산 상각비 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 외환손익 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 운전자본의감소(증가) | -162 | 43 | -26 | -26 | -68 |
| 기타 | 46 | 65 | 56 | -25 | -25 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -118 | -30 | -50 | -52 | 10 |
| 투자자산의 감소(증가) | 0 | -5 | -10 | 15 | 4 |
| 유형자산의 감소 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산의 증가(CAPEX) | -84 | -8 | -4 | -6 | 0 |
| 기타 | -40 | -17 | -36 | -61 | 6 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 7 | 178 | 12 | 96 | 2 |
| 차입금의 증가(감소) | 6 | 0 | 10 | 91 | 2 |
| 사채의증가(감소) | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 자본의 증가 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 배당금 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 기타현금흐름 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 현금의증가(감소) | -42 | 165 | -110 | 32 | 59 |
| 기초현금 | 142 | 100 | 265 | 155 | 188 |
| 기말현금 | 100 | 265 | 155 | 188 | 247 |

재무상태표

| (억원) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025F | 2026F |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 유동자산 | 873 | 992 | 875 | 1,043 | 1,253 |
| 현금성자산 | 100 | 265 | 155 | 188 | 247 |
| 단기투자자산 | 36 | 6 | 1 | 70 | 83 |
| 매출채권 | 384 | 209 | 243 | 269 | 317 |
| 재고자산 | 337 | 486 | 456 | 492 | 579 |
| 기타유동자산 | 16 | 25 | 21 | 23 | 27 |
| 비유동자산 | 289 | 327 | 365 | 353 | 339 |
| 유형자산 | 186 | 182 | 177 | 168 | 155 |
| 무형자산 | 11 | 15 | 20 | 18 | 16 |
| 투자자산 | 27 | 77 | 126 | 115 | 116 |
| 기타비유동자산 | 65 | 53 | 42 | 52 | 52 |
| 자산총계 | 1,162 | 1,319 | 1,241 | 1,396 | 1,591 |
| 유동부채 | 487 | 543 | 602 | 652 | 724 |
| 단기차입금 | 205 | 225 | 235 | 245 | 245 |
| 매입채무 | 44 | 113 | 46 | 51 | 60 |
| 기타유동부채 | 238 | 205 | 321 | 356 | 419 |
| 비유동부채 | 4 | 217 | 184 | 264 | 264 |
| 사채 | 0 | 118 | 132 | 132 | 132 |
| 장기차입금 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 기타비유동부채 | 4 | 99 | 52 | 52 | 52 |
| 부채총계 | 490 | 760 | 786 | 916 | 988 |
| 지배주주지분 | 672 | 559 | 455 | 480 | 603 |
| 자본금 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 자본잉여금 | 222 | 229 | 238 | 244 | 244 |
| 자본조정 등 | -22 | -10 | 1 | 1 | 1 |
| 기타포괄이익누계액 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 이익잉여금 | 410 | 280 | 154 | 174 | 298 |
| 자본총계 | 672 | 559 | 455 | 480 | 603 |

주요투자지표

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025F | 2026F |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| P/E(배) | 10.7 | N/A | N/A | 116.4 | 18.8 |
| P/B(배) | 2.6 | 6.9 | 2.8 | 4.8 | 3.8 |
| P/S(배) | 1.5 | 5.2 | 1.5 | 2.5 | 2.1 |
| EV/EBITDA(배) | 9.1 | N/A | N/A | 76.1 | 19.4 |
| 배당수익률(%) | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EPS(원) | 1,284 | -844 | -923 | 155 | 958 |
| BPS(원) | 5,267 | 4,353 | 3,536 | 3,731 | 4,689 |
| SPS(원) | 9,343 | 5,850 | 6,524 | 7,229 | 8,504 |
| DPS(원) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수익성(%) | | | | | |
| ROE | 27.7 | -17.5 | -23.4 | 4.3 | 22.8 |
| ROA | 14.6 | -8.7 | -9.3 | 1.5 | 8.3 |
| ROIC | 26.6 | -17.0 | -27.4 | 2.5 | 18.7 |
| 안정성(%) | | | | | |
| 유동비율 | 179.4 | 182.6 | 145.4 | 160.0 | 173.1 |
| 부채비율 | 73.0 | 136.0 | 172.6 | 190.8 | 163.7 |
| 순차입금비율 | 13.9 | 30.8 | 59.6 | 54.2 | 31.5 |
| 이자보상배율 | 36.8 | -10.8 | -6.9 | 0.6 | 4.2 |
| 활동성(%) | | | | | |
| 총자산회전율 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 매출채권회전율 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 3.7 |
| 재고자산회전율 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자들의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조-제3조의 7

| 종목명 | 투자주의종목 | 투자경고종목 | 투자위험종목 |
|-------|--------|--------|--------|
| 인텍플러스 | X | X | X |

발간 History

| 발간일 | 제목 |
|------------|----------------------------------|
| 2025.09.23 | 인텍플러스- 후공정 병목 해소 과정에서 빛나는 검사장비업체 |
| 2023.09.18 | 인텍플러스-인공지능 시대의 반도체 첨단 패키징 검사 수혜주 |

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 한국IR협의회(<https://t.me/kirsofficial>) 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받을 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '소중한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '소중한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.